

《微电子器件封装制造技术》

图书基本信息

书名：《微电子器件封装制造技术》

13位ISBN编号：9787121153983

10位ISBN编号：712115398X

出版时间：2012-1

作者：王开建

页数：124

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《微电子器件封装制造技术》

内容概要

本书主要内容包括：微电子器件封装技术概述；微电子器件塑料封装技术，以三端稳压器塑料封装、BGA塑料封装、WL-CSP塑料封装为具体学习任务等。

《微电子器件封装制造技术》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com